1：SCOPE（适用范围）.....3
2：REFERENCE DOCUMENTS（参考文件）.....3
3：FEATURE & DIMENSIONS （特征及尺寸）.....3
3.1. PRODUCT DIMENSION（产品尺寸）.....3
3.2. PCB/PANEL LAYOUT （印刷电路板布局）.....3
3.3. MATERIAL（材料）.....3
3.4. MECHANICAL & ELECTRICAL CHARACTERISTIC （机械及电气特性）...3
3.5. PACKAGING（包装）.....3
3.6. MARKING（标识）.....3
3.7 TRANSPORTATION（运输）.....3
3.8 STORAGE（存贮）.....4
4. ENVIRONMENTAL（环境要求）.....4
4.1. SOLDERABILITY（可焊性）.....4
4.2. RESISTANCE TO SOLDER HEAT（耐焊接热）.....4
4.2.1. Wave Soldering （波峰焊）.....4
4.2.1.1. Preheat（预热）.....4
4.2.1.2. Soldering（焊接）.....4
4.2.1.3. Cool Down （冷却）.....4
4.2.2. INFRARED REFLOW（红外线回流焊）.....4
4.2.2.1. Preheat（预热）.....4
4.2.2.2. Soldering（焊接）.....4
4.2.2.3. Cool Down （冷却）.....4
4.3. CLEANING （清洗）.....4
5. PERFORMANCE AND TEST DESCRIPTION （性能及测试）.....5
5.1. REQUIREMENT（要求）.....5
5.2. TEST CONDITION（测试条件）.....5
5.3. SAMPLE SELECTION（样品选择）.....5
5.4. TEST SEQUENCE（测试顺序）.....5
6. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS （品质保证）.....5
TABLE I：PERFORMANCE REQUIREMENTS 6
TABLE II：PRODUCT QUALIFICATION TEST SEQUENCE 8
TABLE III：REFLOW SOLDERING PROFILE.....9

1. SCOPE（适用范围）

This product specification defines the product performance and the test methods to ascertain the performance of the **SD PUSH CARD CONN**, which is designed and manufactured by Compeny.
本产品规格书规定了由本公司设计生产的 **SD PUSH CARD** 连接器产品的特性及测试方法.

2. REFERENCE DOCUMENTS（参考文件）

MIL-STD-1344A Test method for electrical connector （电子连接器测试方法）
MIL-STD-202F Test method for electrical components （电子零件测试方法）
EIA364 Test method for electrical components （电子零件测试方法）
JIS C 0051 Test method for electrical components （电子零件测试方法）
MIL-G-45204C Specification for gold plating （镀金规格）
IEC-512-3 IEC standard for current carrying capacity tests（IEC电流测试标准）
QQ-N-290A Specification for nickel plating （镀镍规格）
MIL-P-81728A Specification for tin/lead plating （镀锡铅规格）
MIL-T-10727B Specification for tin plating （镀锡规格）
UL498 UL standard for safety of attachment plug and receptacle（UL安规要求标准）
EN/ISO5961 Determination of total lead & cadmium content (总铅和总镉含量测定)
EN1122 Determination of total lead & cadmium content (总铅和总镉含量测定)
EN13346 Determination of heavy metals content (重金属含量测定)
EPA3052 Determination of total lead & cadmium content (总铅和总镉含量测定)

3. FEATURE & DIMENSIONS （特征及尺寸）

3.1. PRODUCT DIMENSION （产品尺寸）

These connectors shall have the dimensions as shown in customer drawing。
本产品的相关尺寸参见客户图面。

3.2. PCB/PANEL LAYOUT （印刷电路板布局）

The recommended PCB layout is shown in customer drawing。
本产品适用的PCB layout参见客户图面。

3.3. MATERIAL （材料）

The harmful material can follow the requirement of RoHS.
本产品使用的材料符合 RoHS 指令要求。

3.4. MECHANICAL & ELECTRICAL CHARACTERISTIC （机械及电气特性）

The connector shall have the mechanical and electrical performance as described in table I：
本产品的机械及电气特性见附表I。

3.5. PACKAGING （包装）

Products shall be packaged according to requirements specified in purchase order for safe delivery. Products required tray or carrier tape should meet the proper specification per purchase order. Connector container and the packaging specification is shown in customer drawing。
产品包装可依客户指定要求。无特殊要求，本产品采用tray盘包装，具体规格见客户图面。

3.6. MARKING（标识）

Manufacturer's name, industry recognized logo, or customer approved marks。
标示制造商的名称，或客户认可的相关标志。

3.7.TRANSPORTATION （运输）

Any vehicle can be adopted for the transportation, but moisture-proof and no mechanical damage.
可采用任何运输工具运输，勿淋湿及机械性损伤。

3.8.STORAGE （存贮）

Temperature: -25℃~+85℃，Relative humidity: ≤80%，Not to storage in corrosive environments A re-qualification test shall be conducted immediately while the storage duration exceed 6 months.
温度：-25℃~+85℃；相对湿度：≤80%；勿贮存于腐蚀环境内。贮存期超过6个月后需重新进行品质确认。

4. ENVIRONMENTAL（环境要求）

4.1. SOLDERABILITY（可焊性）

Connector's solderability can meet MIL-STD-202F standard. Finish shall be free of contaminants.
产品可焊性符合 MIL-STD-202F 标准规定的相关要求，表面不得有污染物.

4.2. RESISTANCE TO SOLDER HEAT （耐焊接热）

4.2.1. Wave Soldering （波峰焊）

Consists of three consecutive phases. 包括三个连续的阶段完成；

4.2.1.1. Preheat（预热）

Increase in temperature not to exceed **4**℃per second. Final preheat temperature will be within **125**℃of solder temperature. 温度增加不超过**4**℃ /秒，最终预热温度不超过**125**℃.

4.2.1.2. Soldering（焊接）

Device leads will be exposed to solder wave at **250**℃for a maximum of 5 seconds. 设备中的引导焊接温度最高**250**℃不超过5秒.

4.2.1.3. Cool Down（冷却）

Cool down in ambient air at approximately **20**℃**to 25**℃. 冷却到周围环境温度**20**℃**~ 25**℃.

4.2.2. INFRARED REFLOW （红外线回流焊）

Three cycles. Each cycle consisting of three consecutive phased. 三个周期，每个周期包括三个连续的阶段完成；

4.2.2.1. Preheat（预热）

Increase in temperature not to exceed 4℃ per second. 温度增加不超过**4**℃ /秒，

4.2.2.2. Soldering（焊接）

Maximum allowable time above reflow temperature of **183** ℃ is **90** seconds. Maximum temperature in this interval is 255℃, not to exceed 10 seconds. 回流焊温度**183**℃以上的时最长不超过 90秒. 最高温度255℃时间不超过10秒.

4.2.2.3. Cool Down（冷却）

Cool down shall not exceed 6℃ per second. 冷却速度不超过6℃/秒. **Note:**（注）Device temperature measurements are referenced from the top-center of the package outer surface. 设备温度量测时以从顶部中间位置测量为准；

4.3. CLEANING （清洗）

Connectors resist to cleaning process. Aqueous Cleaning: Three cycles; each cycle consisting of a maximum of one minute exposure to 54℃ to 66℃ demineralized tap water at a maximum pressure of 30 psi; followed by air drying for 60℃to 90 seconds at 93℃ to 121℃.
产品本身可以承受清洗制程. 水洗：包含三个循环；每个循环包括以下：以最大压力30帕，温度 54℃~ 66℃，去除矿物质的水，用水龙头冲洗最多一分钟，然后用温度 93℃~121℃的空气吹60到90秒；

5. PERFORMANCE AND TEST DESCRIPTION （性能及测试）

5.1. REQUIREMENT（要求）

Product is designed to meet electrical, mechanical, and environmental performance requirements specified in **Table I**.
本产品设计符合附表一所列的机械，电气及环境要求.

5.2. TEST CONDITION （测试条件）

Unless otherwise specified, all tests shall be performed at ambient environmental conditions.
除非特别注明，所有测试在室温条件下完成；

5.3. SAMPLE SELECTION （样品选择）

Test samples shall be selected at random from current production. No test samples shall be reused. Samples are pre-conditioned with 10cycles of durability. Each group shall be containing 5 test samples.
测试样品从现生产的产品中随机抽取，所有测试过的样品不得重复使用. 样品已预先插拔10次，每组测试有5个样品；

5.4. TEST SEQUENCE （测试顺序）

Products qualification test sequence as shown in **Table II.**
产品品质测试顺序见附表二.

6. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS （品质保证）

Compeny is responsible for the quality of the part as it is delivered to customer. Failing lots will be return or other supplier corrective action.
本公司对出给客户的所有产品品质负责，不良批次的产品退回或由供应商做矫正；

TABLE I: PERFORMANCE REQUIREMENTS

Items	Requirements	Test Methods
1.Confirmation of Product 产品确认	Product shall be conforming to the requirements of applicable product drawing. 产品必须满足相关文件的规定	Visually, dimensions and functionally inspected per applicable product drawing. 目视，尺寸及功能依照客户图面检查。
2. Contact resistance (Low Level)接触阻抗	**80** mΩ Max. initial 80 mΩ最大.初态	Subject mated contacts assembled in housing to closed circuit of 10 mA max. at open circuit voltage of 20 mV max. 所述固定在外壳里的端子联结到一个封闭回路中测试：电流10mA，电压20 mV max.。
3. Insulation resistance 绝缘阻抗	**1000** MΩ Min. 1000 MΩ最小	Measure by applying test potential between the adjacent contacts, and between the contacts and ground in the mated connector. MIL-STD-202, Method 302, Condition B (500 V DC±10%). 测试产品端子间以及端子与接地间的电阻，适用：MIL-STD-202, 方法302，条件B (500V DC±10%) 。
4. Dielectric Strength 耐电压	Connector must withstand test potential of 500 V AC for 1 minute. Current leakage must be 1.0 mA max.. 样品必须承受测试电 500V AC，时间一分钟，漏电流不大于1.0 mA.	Measure by applying test potential between the adjacent contacts, and between the contacts and ground in the mated connector. MIL-STD-202, Method 301. 测试产品端子间以及端子与接地间的电压，适用：MIL-STD-202 ，方法 301 。
5. Durability (Repeated Mating/Unmating) 耐久力	Contact Resistance: **100** mΩ Max. And insertion/extraction force must meet the association specification. After testing. 完成插拔测试后接触阻抗不大于100 mΩ，插入拔出力量需要符合协会的要求。	Mate and un-mate connector for 5000 cycle. The insertion force under 10N, and the extraction force meet 1~10N 同配合产品进行5000 次插拔。
6. Temperature rise 温度急变	30° C Max. 不高于30° C	Carry rated current load.0.3A per contact. （UL498）每根端子负载0.3A 电流。（UL498）
7.Vibration Sinusoidal Low Frequency 低频正弦振动	No electrical discontinuity greater then 1 μ sec (s) shall occur. Contact resistance:**100** mΩmax. 不允许出现超过1 μ sec (s) 的瞬间断开，接触阻抗：100 mΩ最大；	Subject mated connector to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.5 mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular plane, 10 mA applied MIL-STD-202, Method 201. 对测试样品，在频率变化每分钟从10-55-10 Hz，振幅 1.5 mm 条件下，在互相垂直的三个面上，每个面2 小时下测量，电流 10 mA ；适用：MIL-STD-202 ，方法 201。

8. Shock 冲击	No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. No damage to product. 不允许出现超过1 μ sec (s) 的瞬间断开，产品无损坏；	Applying an appropriate holder is allowed in vibration test and shock test. MIL-STD-202, Method 213,490m/s2, 3 axes. 使用合适的固定方式，适用方法. MIL-STD -202，方法213，加速度490m/s2，三个轴上均做测试。
Items	**Requirements**	**Test Methods**
9. Thermal shock 热冲击	No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) **100** mΩ max. 产品无损坏，接触阻抗：100 mΩ最大	Temperature range from -55°C to +85°C .Start from -55°C. After 30 min. change to +85°C, change time is no more than 30 seconds. Total 5 cycles. MIL-STD-202, Method 107D,condition A. 温度变化范围： -55°C~+85°C ；从 -55°C 开始，30 分钟后换到+85°C ；转换时间不超过30 秒；共5 个循环。适用：MIL-STD-202 ，方法107D ，条件A。
10. Humidity 恒温恒湿	No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) **100** mΩ max.. Dielectric Strength should be OK, Insulation Resistance should be 100 MΩ min. 产品无损坏，接触阻抗：100 mΩ最大；耐电压测试OK，绝缘阻抗100MΩ最小；	Temperature :40±2° C 96 hours. Relative humidity: 90-95%; Duration: 96 Hours. MIL-STD-202, Method 103, 温度：40±2° C 96 小时；相对湿度：90-95% ；时间：96 小时；MIL-STD-202 ，方法103。
11.Solderability 可焊性	Appearance of the specimen shall be inspected after the test with the assistance of a magnifier capable of giving a magnification of 10 X for any damage such as pinholes, void or rough surface. 样品在测试完成后，用放大倍数为10 倍的显微镜，检查外观损坏如：小孔，空焊，外观粗糙度；	Soldering time: 3 to 5 Seconds Temperature: 255±5°C. 焊接时间：3~5 秒，温度：255±5°C。
12.Resistance to soldering heat 耐焊接热	No damage 产品无损坏	Leave subject product in the 255±5°C chamber for 2 minutes. 产品置于255±5°C 烘箱内2 分钟。
13. Salt Spray 盐雾	Contact Resistance (Low Level) (Final) **100** mΩ max. 接触阻抗(末态) 100 mΩ max.	5±1% salt concentration 24 hours ,35±2°C MIL-STD-202, Method 101 Condition B. 盐水浓度（重量比）5±1%，时间24 小时，温度35±2°C；MIL-STD-202，方法101 ，条件B。
14.High temperature 高温	Contact resistance: **100** mΩ max. 接触阻抗100 mΩ max.	Subject product to 85±2°C for 96 hours continuously. MIL-STD-202, Method 108. 产品置于85 ±2°C 连续96 小时，适用MIL-STD-202, 方法108。

TABLE II: PRODUCT QUALIFICATION TEST SEQUENCE

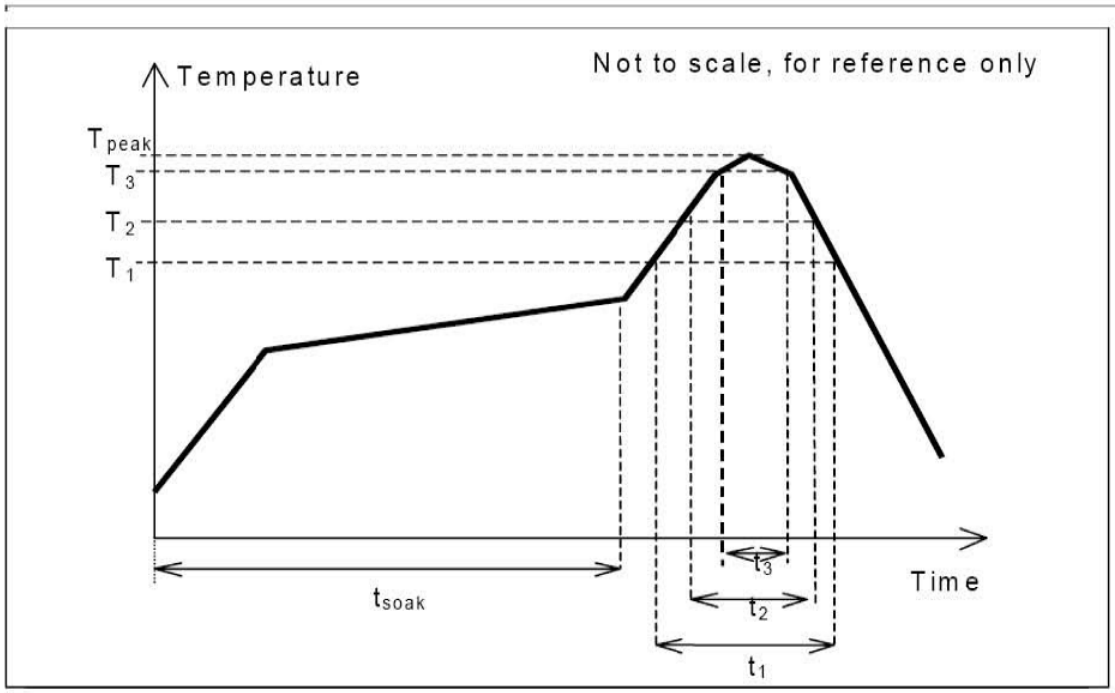
Test Description	Test Group								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Examination of Product 外观	1,7	1,4	1,5	1,5	1,10	1	1	1,9	1,9
2. Contact Resistance (Low Level) 接触阻抗	2,6	2	2,4	2,4,	2,8			2,6	2,6
3. Insulation Resistance 绝缘阻抗	3				3,6, 9			3,7	3,7
4. Dielectric Strength 耐电压	4				4			4,8	4,8
5. Durability 耐久力	5								
6. Temperature rise 温度急变		3							
7. Vibration Sinusoidal Low Frequency 低频正弦振动			3						
8. Shock 冲击				3					
9. Thermal shock 热冲击					5				
10. Humidity 恒温恒湿					7				
11. Solderability 可焊性						2			
12. Resistance to soldering heat 耐焊接热							2		
13. Salt Spray 盐雾								5	
14. High temperature 高温									5

TABLE III:

REFLOW SOLDERING PROFILE

Pb-free reflow profile requirements:

Parameter	Reference	Specification
Average temperature gradient in preheating		2.5°C/s
Soak time	tsoak	2-3 minutes
Time above 217°C	t1	60 s
Time above 230°C	t2	50 s
Time above 255°C	t3	5 s
Peak temperature in reflow	Tpeak	255°C (+5/-0°C)
Temperature gradient in cooling		Max -5°C/s



This profile is the minimum requirement for evaluating soldering heat resistance of components. Heat transfer method used for reflow soldering is hot air convection. The actual air temperatures used to achieve the specified profile is higher and largely dependent on the reflow equipment.

深圳市华宇创精密电子有限公司

保持力试验报告

日期: 2014 年 11月 28 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座						抽样数	5PCS	
料号	HYC29-SD11-100						不良数	0	
自弹/不自弹	不自弹						不良率	0	
测试条件	测试端子脱离胶芯所需的力量.						测量仪器	自动插拔力机	
CRI:	PCS						MIN:	PCS	
检查项目			检查结果					不良数	不良率	判定结果
端子保持力	单PIN保持力最小150g		#1	#2	#3	#4	#5			
		P1	696	705	685	690	710	0	0	OK
		P2	724	715	710	732	720	0	0	OK
		P3	533	520	525	510	535	0	0	OK
		P4	515	510	512	520	512	0	0	OK
		P5	466	460	462	459	455	0	0	OK
		P6	623	620	625	628	630	0	0	OK
		19.21	564	558	550	560	562	0	0	OK
		18.71	699	695	705	701	702	0	0	OK
		18.15	723	720	721	725	720	0	0	OK
		CD	866	850	859	862	865	0	0	OK
		WP	821	830	825	816	822	0	0	OK
总判定	■合格 □不合格									
备 注										

深圳市华宇创精密电子有限公司

插拔力测试报告

日期: 2014 年 11月 15 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座								抽样数	5PCS	
料号	HYC29-SD11-100								不良数	0	
自弹/不自弹	不自弹								不良率	0	
使用卡尺寸	2.10MM								测量仪器	插拔力测试机	
CRI:	PCS								MIN:	PCS	
检查项目			检查结果						不良数	不良率	判定结果
插拔力测试	插入测試速度: 12.5MM/MINUTE- MAX 40N/MAX	插入力	样品	#1	#2	#3	#4	#5	0	0	OK
			结果	3.6	3.7	3.1	3.1	3.07	0	0	OK
	拔出測試速度: 12.5MM/MINUTE- MAX 0.5N/MIN	拔出力	样品	#1	#2	#3	#4	#5	0	0	OK
			结果	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	0	0	OK
总判定	■合格 □不合格										
备 注											

深圳市华宇创精密电子有限公司

高温测试报告

日期: 2014 年 11月 22 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座										抽样数	5PCS	
料号	HYC29-SD11-100										不良数	0	
自弹/不自弹	不自弹										不良率	0	
测试条件	产品置于85±2℃，连续96小时										测量仪器	高温试验机	
CRI:	PCS										MIN:	PCS	
检查项目		检查结果									不良数	不良率	判定结果
1.外观	无明显损伤现象	符合要求									0	0	OK
2.接触阻抗	接触阻抗最大100毫欧		#1		#2		#3		#4		#5				
			测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后			
		P1	19.71	20.5	19.86	24.8	18.15	23.5	18.15	21.2	19.64	20.3	0	0	OK
		P2	18.19	20.3	19.64	22.2	19.86	23.5	19.86	20.3	18.15	22.4	0	0	OK
		P3	20.86	20.8	18.15	20.8	19.64	22.4	19.64	22.4	19.86	23.5	0	0	OK
		P4	21.64	24.8	19.86	20.5	18.15	20.5	18.15	21.5	18.15	22.4	0	0	OK
		P5	19.15	22.2	19.64	20.3	19.86	21.2	19.86	20.8	19.64	20.5	0	0	OK
		P6	19.46	20.8	18.15	20.8	19.86	20.3	18.15	23.5	18.15	21.2	0	0	OK
		19.21	21.64	20.5	19.86	20.5	19.64	22.4	19.86	22.4	19.86	20.3	0	0	OK
		18.71	17.41	21.2	18.15	24.2	18.41	21.5	19.41	20.5	18.15	22.4	0	0	OK
		18.15	18.9	20.1	19.86	23.2	18.48	22.1	20.48	21.2	19.86	21.5	0	0	OK
		CD	27.35	30.5	28.35	29.4	27.54	35.3	28.89	31.2	26.64	29.4	0	0	OK
		WP	28.49	31.3	30.89	30.4	29.48	33.5	27.83	30.6	25.48	30.4	0	0	OK
总判定	■合格 □不合格														
备　注															

深圳市华宇创精密电子有限公司

恒温恒湿测试报告

日期: 2014 年 11月 15 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座										抽样数	5PCS	
料号	HYC29-SD11-100										不良数	0	
自弹/不自弹	不自弹										不良率	0	
测试条件	温度：40±2℃ 96小时，相对湿度90%-95% 96小时										测量仪	恒温恒湿试验机	
CRI:	PCS										MIN:	PCS	
检查项目		检查结果									不良数	不良率	判定结果
1.外观	无明显损伤现	符合要求									0	0	OK
2.接触阻抗			#1		#2		#3		#4		#5				
			测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后			
		P1	21.8	28.6	20.3	28.6	19.8	29.5	18.7	28.6	19.3	29.6	0	0	OK
		P2	20.5	26.9	20.3	27.2	18.3	28.6	18.2	28.2	18.5	28.2	0	0	OK
		P3	19.5	27.8	19	28.6	19.5	28.6	19.9	29.2	19.2	28.2	0	0	OK
		P4	21.8	29.5	18.3	29.6	19.5	27.2	19.6	28.2	18.7	29.5	0	0	OK
		P5	21.8	28.6	19.5	28.2	18.3	28.2	18.2	27.2	18.2	28.6	0	0	OK
		P6	21.8	29.2	19.5	29.2	19.5	29.6	19.9	28.6	19.9	29.6	0	0	OK
		P7	21.8	28.2	18.3	28.2	18.2	28.2	19.6	29.6	19.6	28.2	0	0	OK
		P8	21.8	29.4	19.5	29.5	16.7	28.2	18.4	28.2	18.2	29.2	0	0	OK
		P9	21.8	26.9	19.5	28.6	19.9	29.2	18.5	28.2	19.9	28.2	0	0	OK
		CD	22.2	29.8	22.4	32.1	22.5	30.6	20.9	31.4	22.5	30.7	0	0	OK
		WP	21.9	30.5	20.9	33.2	20.5	29.4	21.8	33.3	20.5	31.8	0	0	OK
3.絕緣阻抗															
			#1		#2		#3		#4		#5		0	0	OK
			测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后	测试前	测试后	0	0	OK
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
总判定	■合格 □不合格														
备 注															

深圳市华宇创精密电子有限公司

接触阻抗测试报告

	产品名称:	SD 短体沉板 卡座				检验数:	5PCS					日期:	2014.11.15			
	测量仪器:	导通测试仪				不良数:	0					不良率:	0			
	序号 / 模号	标准电阻	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	CD	WP	测量平均值	单位	判定
	1	≤100mΩ	21.77	19.13	16.64	18.2	19.8	21.64	18.71	18.66	22.35	22.23	30.20	20.85	mΩ	OK
电阻测试	2	≤100mΩ	20.22	20.5	17.55	18.11	18.25	19.35	18.15	18.25	20.89	21.89	29.58	20.25	mΩ	OK
	3	≤100mΩ	19.88	20.4	19.54	19.35	19.53	20.26	19.86	19.25	21.83	22.54	28.64	21.01	mΩ	OK
	4	≤100mΩ	18.74	19.88	18.24	19.2	19.5	20.26	19.64	18.48	20.18	20.48	28.41	20.27	mΩ	OK
	5	≤100mΩ	20.48	19.78	16.67	18.35	18.32	18.98	18.41	19.21	20.52	20.34	29.65	20.06	mΩ	OK
	6															
	7															
	8															
	9															
	10															
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															
	18															
	判定结果	■ 合格						□ 不合格								

深圳市华宇创精密电子有限公司

可焊性测试报告

日期：2014 年 11 月 18 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座					检验数		5pcs
料　号	HYC29-SD11-100					不良数		0
A Q L	MIL-HY-202F					不良率		0
测试设备	锡炉							
测试条件	炉温255±5°C,时间3～5秒，吃锡面积95%以上。							
测试时间	2014.11.19							
项目	测试结果					不良数	不良率	判定结果
1.外观	无明显损伤现象					0	0	ok
2.沾锡面积在95%以上	#1	#2	#3	#4	#5			
	OK	OK	OK	OK	OK	0	0	ok
总判定	■合格　　□不合格							
备　注								

深圳市华宇创精密电子有限公司

耐电压测试报告

	产品名称:	SD 短体沉板 卡座			检验数:	10PCS			日期:	2014.11.16		
	测量仪器:	耐高压测试仪			不良数:	0PCS			不良率:	0		
	测试条件: 电压：250V AC，500V DC。 时间：一分钟											
	序号 / 模号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CD	WP
	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
耐高压测试	2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	备注： 耐高压测试后，没有发现放电，烧焦或击穿的现象。											
	判定结果	■ 合格				□ 不合格						

文件编号：Q-4-008 C/0

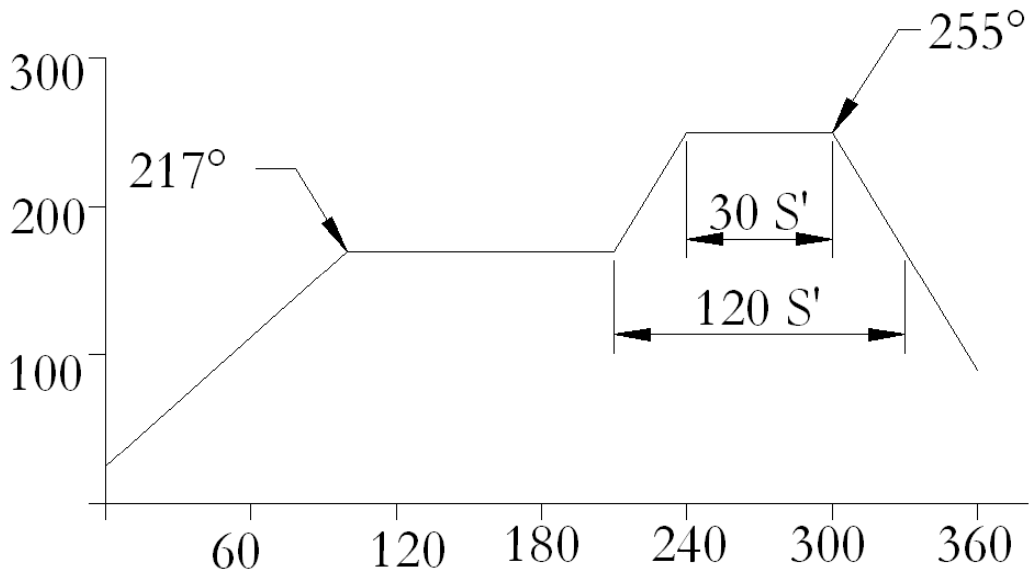
深圳市华宇创精密电子有限公司

耐焊接热测试报告

日期: 2014 年 11月 16 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座		抽样数	5PCS	
料号	HYC29-SD11-100		不良数	0	
自弹/不自弹	不自弹		不良率	0	
测试条件	产品与PCB板同时处于温度255±5℃时间10秒正负5秒内		测量仪器	回焊炉	
CRI:	PCS		MIN:	PCS	
检查项目		检查结果	不良数	不良率	判定结果
1.外观	无明显损伤现象	符合要求	0	0	OK

测試爐溫曲線



总判定	■合格 □不合格
备 注	

深圳市华宇创精密电子有限公司

耐久测试报告

日期: 2014 年 11月 15 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座		抽样数	5PCS	
料号	HYC29-SD11-100		不良数	0	
自弹/不自弹	不自弹		不良率	0	
使用卡尺寸	1.40MM		测量仪器	寿命测试仪	
CRI:	PCS		MIN:	PCS	
检查项目			不良数	不良率	判定结果
2000次	插卡时端子与卡接触是否充分（是）		0	0	OK
	插卡时CD端子与外壳是否接触（否）		0	0	OK
	插卡时WP端子与外壳是否接触（是）		0	0	OK
	插卡时是否出现跪PIN（否）		0	0	OK
	插卡时是否出现退PIN（否）		0	0	OK
	弹卡是否顺畅（是）		0	0	OK
3000次	插卡时端子与卡接触是否充分（是）		0	0	OK
	插卡时CD端子与外壳是否接触（否）		0	0	OK
	插卡时WP端子与外壳是否接触（是）		0	0	OK
	插卡时是否出现跪PIN（否）		0	0	OK
	插卡时是否出现退PIN（否）		0	0	OK
	弹卡是否顺畅（是）		0	0	OK
5000次	插卡时端子与卡接触是否充分（是）		0	0	OK
	插卡时CD端子与外壳是否接触（否）		0	0	OK
	插卡时WP端子与外壳是否接触（是）		0	0	OK
	插卡时是否出现跪PIN（否）		0	0	OK
	插卡时是否出现退PIN（否）		0	0	OK
	弹卡是否顺畅（是）		0	0	OK
总判定	■合格	□不合格			
备　注					

深圳市华宇创精密电子有限公司

盐雾测试报告

日期：2014 年 11 月 18 日

产品名称	SD 短体沉板 卡座	检验数	10pcs
料　号	HYC29-SD11-100	不良数	0
A Q L	MIL-HY-202F	不良率	0
测试设备	盐雾喷雾试验机LS8809-60		
测试时间	从　2014.11.18 8:30　到　2014.11.19　8:30　　共计　24 小时　　分		

项目	设定	项目	设定
氯化钠浓度	5%±0.1	压缩空气压力	1±0.1Kg/cm²
试验室温度	35℃±1℃	喷雾率	1～3ml/80cm²/h
饱和空气桶温度	47℃±1℃	升温时间	40分钟
试验室相对温度	85%以上	盐水桶容量	9L

散件名称：SD 沉板外壳（半金镍） SD 沉板端子（半金雾锡）

测试过程中是否发生中断：　　□是　　■否

表面电镀层是否发黄，发黑现象：　　□是　　■否

判定结果	■合格　　□不合格
备　注	镀Ni:24H　　镀Au:48H　　镀Sn:8H

深圳市华宇创精密电子有限公司

绝缘阻抗测试报告

	产品名称:	SD 短体沉板 卡座			检验数:	10PCS			日期:	2014.11.18		
	测量仪器:	绝缘阻抗测试仪			不良数:	0PCS			不良率:	0		
	测试条件：额定电压：500V DC　　测试标准：绝缘阻抗值：1000MΩ MIN											
	序号 / 模号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CD	WP
	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
绝缘阻抗测试	2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	3	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	10	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	备注： 采用绝缘测试仪分别测试产品相邻端子PIN位之间绝缘阻抗，全部显示PASS，无绝缘阻抗值低于1000MΩ之情况。											
	判定结果	■ 合格				□ 不合格						